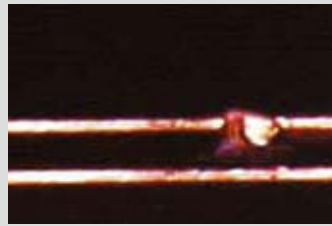


【原因・判断ポイント・発生工程】積層板表面に付着した糊の上に銅めっきされた為、めっき表面が凹凸状になり、DFRが密着出来ない部分がET液に食われて出来たもの（銅めっき～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】层压板表面存在胶迹，镀铜后镀层表面凹凸，DFR压合不紧，被ET液腐蚀而引起的（镀铜～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
As copper plating is made on a CCL on which an adhesive remained, the plated surface of this area is rough and the portion where dry film does not firmly adhere is etched. (Copper plating – etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×

1-2-1-7 皿型厚み欠け／厚碟形的缺口 / Dish shaped nick

【特徴】 厚さ方向に皿状に食われている欠け

【特征】 在铜厚方向有腐蚀的碟形缺口。

【Characteristics】 Nick in the thickness direction in the form of a dish

【原因・判断ポイント・発生工程】薬液残渣若しくは、DFRの下側に介在した異物、ラミネートロール傷等によりDFRが密着不良となり、ET液に食われてできたもの（DFRラミネート～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】药液的残渣或者DFR下侧夹杂杂物，抑或压膜辊轮划伤等，致使DFR压合不紧，被ET液腐蚀而引起的（DFR压合～ET工序）。

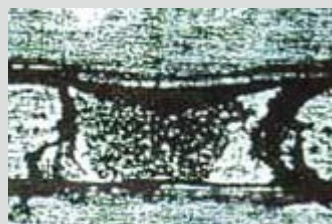
【Causes/processes involved/keys to judgment】
Poor adhesion of dry film brought about by a chemical residue, a foreign object below dry film or a scratch on the lamination roll, etc induces etching of conductor. (Dry film lamination – etching process)



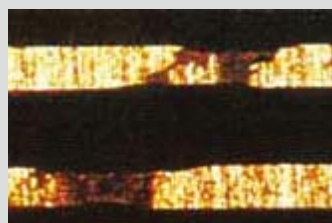
【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
ラミネートロール傷によるもの
顕微鏡倍率×50
【注釋】
压膜辊轮划伤引起的
显微镜倍率 ×50
【Comments】
Caused by scratch on lamination roll
Magnification: ×50